



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

КОКИ S3X58-M650-7. Бессвинцовая паяльная паста, специально разработанная для ICT



Паяльная паста KOKI S3X58-M650-7 специально разработана для ICT. KOKI S3X58-M650-7 рекомендуется применять для пайки микросхем в корпусах QFN, BGA, LGA. В состав пасты добавлен специально разработанный флюс, минимизирующий количество пустот в выводах корпусов при пайке. Подходит для ICT-тестов.

KOKI S3X58-M650-7 препятствует накоплению густых остатков флюса после пайки. Бессвинцовая паяльная паста не содержит в своем составе галогенов (halogen-free).

Технические характеристики

Паяльная паста	s3x58-m650-7
Состав сплава	Sn 96,5%, Ag 3,0%, Cu 0,5%
Форма частиц	сферическая
Размер частиц (µm)	20-38
Температура плавления сплава (°C)	217-219
Содержание галогенов	0,0
Тип флюса	ROLO

Содержание флюса (%)	11.5±1.0
Вязкость (Pa.S) *1	200±30 *2
Коррозия медной пластины *2	соответствует
Время жизни после нанесения	> 48 часов
Время хранения при температуре 0~10 °C	6 месяцев

*1 ?????????? ?????????? ?????????? ????, PCU-2 ??? 25 °C, 10 ???/???

*2 ? ?????????????? ?? ????????????? JIS

Техническая документация

[Техническая информация S3X58-M650-7 \(ENG\)](#)

[Техническая информация S3X58-M650-7 \(РУС\)](#)